

Technisches Datenblatt Schichtlot HPW-502AgCu



Cadmiumfrei

Norm	Bezeichnung
DIN EN ISO 17672:2010	-
DIN EN 1044	AG502 + Cu
Din 8513	L-Ag49 + Cu
EN ISO 3677	B-Ag49ZnCuMnNi-680/705

Zusammensetzung:

Ag	Cu	Zn	Mn	Ni
49%	28%	21%	2,5%	0,50%

Zulässige Verunreinigungen

Al	Bi	Cd	P	Pb	Gesamt
0,0010%	0,0300%	0,0300%	0,0080%	0,0250%	0,1500%

Technische Angaben

Schmelzbereich	
Solidus	680°C
Liquidus	705°C
Arbeitstemperatur	690°C
Dichte	8,9 g/cm ³
Dehnung	ca. 35%

Wärmequellen

Flammlötverfahren, Induktionserwärmung und Ofenlöten.

Anwendungen

HPW-502AgCu ist ein niedrigschmelzendes Silberhartlot mit einer Zwischenschicht aus Kupfer. Die Kupferschicht dient zur Spannungsminimierung während des Lötprozesses. Die zu erreichende Festigkeit der Lötstelle hängt von den Grundwerkstoffen ab.

Aufmachungen

Formteile und Folien auf Anfrage.